



平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

平成24年5月9日

上場会社名 株式会社テラプローブ 上場取引所 東
 コード番号 6627 URL http://www.teraprobe.com/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 渡辺 雄一郎
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員CFO (氏名) 神戸 一仁 TEL 045-476-5711
 定時株主総会開催予定日 平成24年6月25日 配当支払開始予定日 ー
 有価証券報告書提出予定日 平成24年6月26日
 決算補足説明資料作成の有無：有
 決算説明会開催の有無：有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(1) 連結経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期	24,190	13.1	2,710	△47.7	2,402	△50.3	△5,529	ー
23年3月期	21,381	19.9	5,181	79.1	4,835	87.0	4,151	86.1

(注) 包括利益 24年3月期 △5,359百万円 (ー%) 23年3月期 4,449百万円 (78.6%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
24年3月期	△595.74	ー	△25.0	5.3	11.2
23年3月期	509.44	ー	20.1	11.6	24.2

(参考) 持分法投資損益 24年3月期 ー百万円 23年3月期 ー百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
24年3月期	41,088	21,198	47.1	2,084.25
23年3月期	50,325	26,557	49.5	2,681.80

(参考) 自己資本 24年3月期 19,347百万円 23年3月期 24,893百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
24年3月期	9,813	△10,671	△804	5,557
23年3月期	10,382	△8,503	2,532	7,211

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当 率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
23年3月期	ー	0.00	ー	0.00	0.00	0	ー	ー
24年3月期	ー	0.00	ー	0.00	0.00	0	ー	ー

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

当社グループが属する半導体業界は市場環境が短期間に変化するという特徴があり、1年間の業績予想を作成することが困難であります。従いまして、当社グループの連結業績予想につきましては、翌四半期の業績予想のみを開示することといたします。

また、通期業績予想を作成することが困難であるため、配当予想についても開示いたしておりません。

平成25年3月期第1四半期の業績予想は以下の通りとなります。

売上高 6,200百万円、営業利益 350百万円、経常利益 300百万円、四半期純利益 200百万円、1株当たり四半期純利益 21円55銭

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 有
 新規 1社（社名）株式会社テラミクロス、 除外 1社（社名）－
 （注）詳細は、添付資料16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無
- ② ①以外の会計方針の変更： 無
- ③ 会計上の見積りの変更： 無
- ④ 修正再表示： 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	24年3月期	9,282,500株	23年3月期	9,282,500株
② 期末自己株式数	24年3月期	－株	23年3月期	－株
③ 期中平均株式数	24年3月期	9,282,500株	23年3月期	8,149,056株

(参考) 個別業績の概要

1. 平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期	19,080	5.2	2,646	△37.2	2,297	△40.7	△6,091	－
23年3月期	18,144	14.6	4,215	76.3	3,874	86.0	3,801	84.2

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期	△656.19	－
23年3月期	466.45	－

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円 銭	円 銭	
24年3月期	33,395	18,504	18,504	24,595	55.4	1,993.46	2,649.65	
23年3月期	45,399	24,595	24,595	24,595	54.2	2,649.65	2,649.65	

(参考) 自己資本 24年3月期 18,504百万円 23年3月期 24,595百万円

2. 平成25年3月期の個別業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

当社が属する半導体業界は市場環境が短期間に変化するという特徴があり、1年間の業績予想を作成することが困難であります。従いまして、当社の業績予想につきましては、翌四半期の業績予想のみを開示することといたします。

平成25年3月期第1四半期の業績予想は以下の通りとなります。

売上高 4,200百万円、営業利益 350百万円、経常利益 300百万円、四半期純利益 200百万円、1株当たり四半期純利益 21円55銭

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

業績予想の前提となる仮定等については、添付資料P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績	2
(1) 経営成績に関する分析	2
(2) 財政状態に関する分析	3
(3) 利益配分に関する基本方針	4
(4) 事業等のリスク	4
(5) 継続企業の前提に関する重要事象	4
(6) 企業集団の状況	5
2. 経営方針	7
(1) 会社の経営の基本方針	7
(2) 目標とする経営指標	7
(3) 中長期的な会社の経営戦略	7
(4) 会社の対処すべき課題	7
3. 連結財務諸表	8
(1) 連結貸借対照表	8
(2) 連結損益及び包括利益計算書	10
(3) 連結株主資本等変動計算書	12
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	14
(5) 継続企業の前提に関する注記	16
(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項	16
(7) 追加情報	17
(8) 連結財務諸表に関する注記事項	18
(連結貸借対照表関係)	18
(連結損益及び包括利益計算書関係)	19
(連結株主資本等変動計算書関係)	20
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)	20
(税効果会計関係)	21
(セグメント情報等)	23
(関連当事者情報)	28
(企業結合等)	29
(1株当たり情報)	30
(重要な後発事象)	30

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当連結会計年度の経済環境は、東日本大震災の影響が残る中、タイの洪水が発生するなど自然災害の影響による企業の生産活動の低迷や、円高の影響による輸出産業の低迷など、国内経済は厳しい状況で推移いたしました。

当社グループが属する世界の半導体市場は、震災直後に一時的な需要増加はあったものの、上記洪水により一部部品の供給が不足したほか、製品組み立てが滞るなどの原因で、半導体の生産も調整を余儀なくされ、低調に推移いたしました。

しかし、当社グループは、下期から株式会社テラミクロスが新たに連結子会社に加わったことなどにより、売上高を伸ばすことができました。

一方、当社九州事業所では平成18年の事業所開設以来、国内IDM(半導体の回路設計から製造、販売までを手掛けるメーカー)を顧客としてSoC(システム・オン・チップ)製品のウエハテストを中心にシステムLSI事業を拡大してまいりました。現在では70台を超えるテスト装置を保有し、国内トップクラスの規模となっております。しかしながら、常に市況の激しい変化にさらされ、多額の投資にもかかわらず、安定的なビジネスを確保できない状況が続き、これまで赤字を計上する状況が続いております。

この間、海外を含む新規顧客の獲得により顧客数を増やし、SoC製品から高い成長性が期待できるイメージセンサやアナログ製品など製品分野も拡大してまいりました。また、従来の顧客の繁閑に稼動を左右される形態から、より顧客とのパートナーシップを強化した安定的な稼動を確保できる形態への転換にも挑戦してまいりました。しかしながら、世界的な半導体市場の変化は早く、SoC製品から他の製品分野へのシフトは不十分な状況にあります。このような状況から、九州事業所の将来の収益性を保守的に見積もった結果、固定資産の減損処理を行うこととなりました。

このような状況により、当連結会計年度における当社グループの売上高は24,190百万円(前年同期比13.1%増)、営業利益は2,710百万円(同47.7%減)、経常利益2,402百万円(同50.3%減)となりました。特別利益は1,069百万円(前年同期は246百万円)となり、主に、平成23年10月1日に株式会社テラミクロスを株式取得により連結子会社としたことに伴う負ののれん559百万円を計上しております。一方、特別損失は8,195百万円(前年同期は201百万円)となり、主に、エルピーダメモリ株式会社の会社更生法申請に伴い、同社向け債権に対して計上した貸倒引当金2,701百万円、当社九州事業所で保有している固定資産の減損処理に伴う減損損失として5,388百万円を計上しております。これらの結果、当期純損益は5,529百万円の損失(前年同期は4,151百万円の利益)となりました。この業績を真摯に受け止め、常勤取締役及び執行役員の報酬を平成24年1月から3月まで最大20%減額しておりましたが、この減額措置を平成24年6月まで延長いたします。また、管理職の賞与についても減額を検討してまいります。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。なお、セグメント別の業績には連結調整額、為替換算レート調整額及びセグメント別に配分されない費用を含んでおりません。

(メモリ事業)

メモリ事業におきましては、DRAM市場の悪化に伴い当社のテスト受託も期初の予想ほどの伸びがなかったことなどから、昨年度から当年度上期にかけて行った設備投資にともなう償却費の増加をカバーすることができませんでした。また、DRAM以外のメモリ製品につきましても、受託量が減少し、低調に推移いたしました。

これらの結果、当連結会計年度のメモリ事業の売上高は19,745百万円(前年同期比0.7%増)、セグメント利益は4,970百万円(同30.2%減)となりました。

(システムLSI事業)

システムLSI事業におきましては、既存の受託製品では上記洪水の影響やデジタル家電の販売不振に伴い、顧客の生産調整があったこと及び新規受託を見込んでいた製品の生産がずれ込んだことなどにより低調に推移いたしました。

しかし、新規顧客の獲得や新規製品の受託もあり、また、新たに連結子会社に加わった株式会社テラミクロスの売上も加わり、売上高は大幅に増加いたしました。利益面では既存製品の受託減少を補うまでには至りませんでした。

これらの結果、当連結会計年度のシステムLSI事業の売上高は4,529百万円(前年同期比154.1%増)、セグメント損益は998百万円の損失(前年同期は872百万円の損失)となりました。

②翌連結会計年度の見通し

当社が属する半導体業界は市場環境が短期間に変化するという特徴があり、1年間の業績予想を作成することが困難であります。従いまして、当社の業績予想につきましては、翌四半期の業績予想のみを開示することといたします。

(2) 財務状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における総資産は41,088百万円となり、前連結会計年度末比9,236百万円の減少となりました。これは主に、エルピーダメモリ株式会社の会社更生法申請に伴い破産更生債権等に対して貸倒引当金2,701百万円を計上したこと、システムLSI事業の固定資産に対して減損損失5,388百万円を計上したこと及び設備代金の支払い等により現金及び預金が1,653百万円減少したことによるものです。

負債は19,890百万円となり、前連結会計年度末比3,877百万円の減少となりました。これは主に、リース債務が2,393百万円減少し、未払金が設備購入代金の支払い等により2,517百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が694百万円増加したことによるものです。

純資産は21,198百万円となり、前連結会計年度末比5,359百万円の減少となりました。これは主に、当期純損失の計上により利益剰余金が5,529百万円減少したことによるものです。これらの結果、自己資本比率は47.1%となり、前連結会計年度末比2.4ポイント減少いたしました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は5,557百万円となり、前連結会計年度末比1,653百万円の減少（前年同期比22.9%減）となりました。

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9,813百万円の純収入（前年同期比5.5%の収入減）となりました。これは主に、減価償却費の計上9,219百万円、システムLSI事業における減損損失の計上5,388百万円、エルピーダメモリ株式会社の会社更生法申請に伴い破産更生債権等に対し計上した貸倒引当金2,701百万円などにより資金が増加しましたが、一方で、税金等調整前当期純損失の計上4,723百万円、法人税等の支払1,256百万円により資金が減少したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、10,671百万円の純支出（前年同期比25.5%の支出増）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出10,629百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、804百万円の純支出（前年同期は2,532百万円の純収入）となりました。これは主に、リース債務の返済による支出6,699百万円と、セール・アンド・リースバック取引による収入5,895百万円によるものです。

（参考）キャッシュ・フロー 関連指標の推移

	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
自己資本比率（%）	49.9	49.5	47.1
時価ベースの自己資本比率（%）	—	43.3	19.5
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）	1.35	1.52	1.36
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）	29.9	44.3	38.9

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

（注2）平成22年3月期の時価ベースの自己資本比率は、株式時価総額が算定不能ですので記載していません。

（注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注4）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

(3) 利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題と位置づけており、その方針としては、企業価値の向上とのバランスに配慮しつつ、収益状況に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。

平成24年3月期末時点では利益剰余金がマイナスとなっており、配当等の利益還元は実施できません。配当可能な状態になった場合の配当水準については、各事業年度の財政状態、経営成績及び将来に向けた事業計画等を勘案しながら、利益還元の方法、比率等を検討していく予定であります。

内部留保資金については、健全な財務体質の構築、維持及び積極的な事業展開のために使用いたします。

(4) 事業等のリスク

① 当社の主要顧客であり、大株主であるエルピーダメモリ株式会社の会社更生法適用について

(5) 継続企業の前提に関する重要事象をご参照ください。

② 特定顧客への依存について

当社グループは、エルピーダメモリ株式会社を主要顧客として事業を展開しております。当社グループにおけるエルピーダグループへの売上比率の推移は以下のとおりとなっております。

	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
売上比率	74.6%	73.0%	67.5%
内、エルピーダメモリ(株)分	72.1%	70.6%	66.2%

エルピーダメモリ株式会社が会社更生法による事業の再建を目指す過程で生産数量や生産品種の見直しを行うことにより、当社グループへのテスト業務の委託を大きく減少させた場合には、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また当社グループがテスト業務を受託しているその他の主要顧客のいずれかが、当社グループへのテスト業務の委託を大きく減少させた場合、又は何らかの理由により顧客の事業環境に大きな変化が生じた場合等には、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

③ 経済状況について

当社グループの属する半導体業界が生産する製品は、PCをはじめ、携帯電話、デジタル家電など幅広い分野で使用されており、平成20年の金融危機のように市場でこれらの最終製品の販売状況が急激に悪化した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループの受託品のうち負荷が高い製品と低い製品の比率が大きく変動した場合や、受託量が大きく減少した場合、当社グループの保有するテスト装置の稼働率が急激に低下し、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

④ 資金について

当社グループの事業は設備投資に多額の資金が必要であり、現状の事業計画においても新たなビジネスの獲得に伴う設備投資が予定されています。これらの設備投資に関して、必要な資金の調達が可能であると判断しておりますが、当社の主要顧客の再建計画によっては、当社業績が大きく影響を受ける可能性があることや経済環境の急激な変動等により予定していた資金調達が出来なくなった場合、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 継続企業の前提に関する重要事象

当社の主たる株主であり、当社グループ売上高の約66%を占める主要顧客でもあるエルピーダメモリ株式会社は、平成24年2月27日に東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申し立てを行い、平成24年3月23日に同裁判所よりエルピーダメモリ株式会社に対し会社更生手続開始決定がなされました。

エルピーダメモリ株式会社は、会社更生手続開始の申し立て後もDRAM事業を継続しており、当社は引き続き申し立て以前と同レベルのウエハテスト業務を同社より受託しております。しかし、期末時点ではエルピーダメモリ株式会社の再建に向けた更生手続が開始されたものの、更生計画の認可までには至っていないという状況にあるため、エルピーダメモリ株式会社の将来に関する不確実性を当社が完全に排除することは困難であります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

(6) 企業集団の状況

当社グループは、当社（株式会社テラプローブ）、国内連結子会社（株式会社テラミクロス）及び海外連結子会社（TeraPower Technology Inc.）により構成されており、半導体製造工程におけるウエハテスト及びファイナルテストの受託とウエハレベルパッケージ（WLP）受託を主たる業務としております。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

① メモリ事業

当社グループのメモリ事業の主な業務はDRAMのウエハテスト業務の受託であり、主に広島事業所とTeraPower Technology Inc.で行っております。当社グループは、当社を持分法関係会社とするエルピーダメモリ株式会社のような日本国内の半導体メーカーや、海外の半導体メーカー、ファブレス等からウエハテストを受託していません。

一般的にウエハテストは、顧客から支給されたテストプログラムを使用して、ウエハ上に作り込まれた半導体チップの電気特性をテストし、良品・不良品の判別を行い、その結果を顧客に提供して業務が完了します。これに加えて、当社グループでは、多数個同時測定用プログラムを開発したり、プローブカード設計を受託するなど、顧客のウエハテストのコスト低減に貢献しております。さらに、メモリ事業の売上の多くを占めるDRAMでは、半導体チップにレーザーによる加工を施し、顧客の製造した半導体チップの歩留確保、向上を行っております。

また、マルチチップパッケージ（MCP）など複数の異なるチップを封入する半導体デバイスでは、1個のチップに不具合があると他の正常なチップまで廃棄せざるを得ず、全体の歩留低下とコストアップの問題を発生させてしまいます。当社グループでは、このような顧客のコストアップを回避するために、あらかじめ半導体に高温、高電圧をかけることで、不良となるおそれのある製品を選別するバーンインテストをウエハ状態で行い、製造工程における不具合品を選別します。当社グループでは、この技術（ウエハレベルバーンイン技術）を確立し、製品の信頼性を高めております。

今後、高機能化が進み、コスト面からも更なる微細化の進展が予想され、また半導体製品の用途が自動車などの信頼性が重視される分野に広がることで、これらの歩留向上や品質、信頼性の確保に有用な技術はますます重要な差別化ポイントとなってくるものと考えております。

また、当社グループでは、半導体の受託生産が盛んな台湾において、連結子会社のTeraPower Technology Inc.が事業を行っております。台湾においても、国内で培ったメモリのテスト技術をもとに、国内と同じ品質でウエハテスト業務を提供し、顧客のテストコスト低減に努めております。

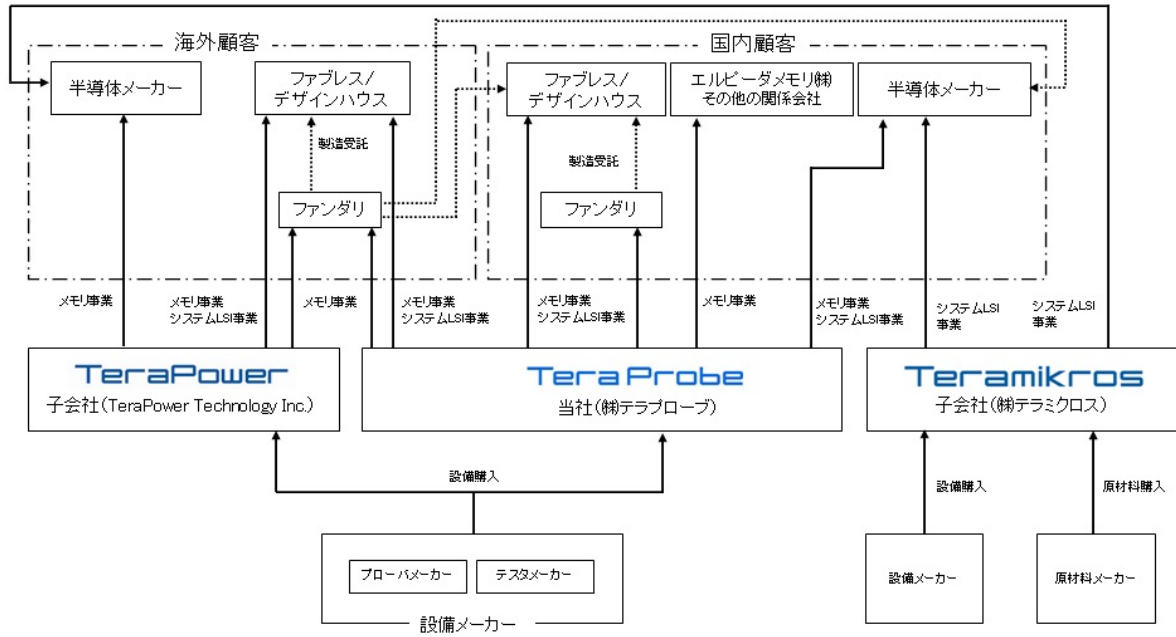
② システムLSI事業

システムLSI事業は、当社では国内外の半導体メーカーやファブダリが生産したSoC、イメージセンサ、アナログなどの半導体製品のウエハテスト業務の受託が中心で、その他にファイナルテスト業務も受託しており、主に九州事業所で行っております。また、台湾にある連結子会社のTeraPower Technology Inc.においてもSoC製品のテスト業務を受託しております。さらに株式会社テラミクロスでは、MEMSセンサやアナログ半導体などのWLPを受託しております。

システムLSI事業におけるウエハテストも、一般的には顧客から支給されたテストプログラムを使用してテストし、ウエハ上に作り込まれた半導体チップの特性について、良品・不良品の判別を行い、その結果を顧客に提供して業務が完了します。システムLSI事業における受託製品はメモリ事業と比較すると多品種少量生産の場合が多く、製品によりテスト機器やテスト環境が異なるなどの特徴があります。そのため顧客の様々なニーズに対応していく技術力と柔軟性が求められております。

株式会社テラミクロスで受託しているWLPは、パッケージ後の製品サイズが薄く、小さいという特徴があり、ウエハ状態で全てのパッケージ工程を完了するため、高い生産性を誇ります。

以上に述べた事項を事業系統図に示すと次のとおりです。



2. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、常にチャレンジ精神と誇りをもってビジネスに取り組み、技術を磨き、生産の効率化を進め、世界中のお客様が心から満足し信頼できるパートナーとして、新たな価値創造に貢献するという経営理念の下、半導体製品のテスト技術の向上と、テストの効率化をとおして社会に貢献して参ります。

当社グループが先進のテスト技術で効率的なテストサービスを提供することが、顧客製品競争力の向上に寄与し、ひいては半導体業界のさらなる発展に貢献することで、当社グループの優位性が広く認識され、さらなる業容の拡大につながるものと考えております。

このように当社グループはテスト技術向上とテスト効率の効率化を追求し、業容を拡大することで、株主、投資家の皆様の期待に応えてまいります。

(2) 目標とする経営指標

当社グループは、健全な成長を継続し、株主への利益還元と全てのステークホルダーの満足度の向上を図るため、収益性の維持・向上が重要であると考え、その指標としてROE(自己資本利益率)を重視しております。また、目標ROE水準の実現に向けた収益性と健全性のバランスの観点から、営業利益率や自己資本比率等の指標にも留意して経営しております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループの中長期的な経営戦略は、当社の強みである技術力、資金力を強化しつつ、競合他社との明確な差別化を図り、価格競争力及び非価格競争力における優位性を生かした顧客開拓、受託製品の増加を目指すことであります。

そのために、顧客ニーズや、市場・技術・競合企業に関する情報収集力を高め、テスト技術、治具設計やプログラム開発などを強化し、最先端装置の導入を継続するとともに、パッケージングを含めたサプライチェーンの構築を進めてまいります。

これらの取組による提案力、顧客サポート力の向上により、日本国内においては水平分業のメリットを積極的に提案し、顧客のパートナーとしての地位を確立することで、新規かつ安定的なテスト受託を目指します。海外においては、特にサプライチェーンの利便性と技術サポートを望む顧客のニーズに応えることにより、新規製品のテスト受託を目指します。

また、これらの取組を実行する基礎となる、健全な財務体質と機動的な資金調達能力の維持・向上にも取り組んでまいります。

(4) 会社の対処すべき課題

「1. 経営成績 (5) 継続企業の前提に関する重要事象等」に記載のとおり、当社グループの主要な取引先であるエルピーダメモリ株式会社においては、再建に向けた更生手続が開始されたものの、更生計画の認可までには至っていないという状況にあるため、当社には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

当社グループでは、特定の取引先に売上高が偏っている状況を変え、より強固な財務体質を築くために、以下のような施策を実行してまいります。

なお、エルピーダメモリ株式会社の更生計画が認可され、当社へのウエハテスト業務委託が継続される場合には、このような不確実性は解消すると考えております。

① システムLSI事業の収益改善

今後は、製品ごとの収益性をより精査し、採算性の低い製品については受託の可否を検討し、低稼働の設備についてはそのあり方を見直してまいります。また、新しい製品の受託にあたっては投資リスクを今まで以上に精査し、顧客とのWin-Winを実現できる関係の確立を目指します。さらに、連結子会社である株式会社テラミクロスが行うWLP(ウエハレベルパッケージ)の省スペース性を武器に、成長しているスマートフォンなどのモバイル製品に搭載される半導体のウエハテストとWLPの受託に注力し、テストとWLPを一貫させたターンキーソリューションの提供による事業拡大を目指してまいります。

コスト削減については、すでに役員報酬の削減を実施しておりますが、これに加えて管理職の賞与削減、外部委託の見直し等より一層のコスト削減を徹底してまいります。

② さらなる資金調達の検討、実施

当社グループでは、財務基盤の安定化のために、様々な資金調達策を検討し、実施してまいります。また、保有設備の選別を進め、低稼働資産の売却を促進してまいります。

3. 連結財務諸表
 (1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,211,189	5,557,662
受取手形及び売掛金	3,774,836	3,537,532
製品	12,675	27,861
仕掛品	139,692	253,265
原材料及び貯蔵品	24,263	91,012
繰延税金資産	184,377	264,977
未収入金	3,293,869	494,390
その他	58,027	449,461
貸倒引当金	—	△295
流動資産合計	14,698,932	10,675,868
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	4,322,848	3,004,029
機械装置及び運搬具（純額）	27,037,352	22,886,511
土地	603,701	899,664
建設仮勘定	1,350,530	183,544
その他（純額）	941,990	1,828,191
有形固定資産合計	※1 34,256,423	※1 28,801,940
無形固定資産		
投資その他の資産	490,844	704,186
繰延税金資産	388,238	8,557
破産更生債権等	—	3,120,838
その他	490,896	478,564
貸倒引当金	—	△2,701,160
投資その他の資産合計	※1 879,134	※1 906,800
固定資産合計	35,626,402	30,412,926
資産合計	50,325,335	41,088,795
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	479,490	1,173,851
短期借入金	1,580,400	1,858,764
1年内返済予定の長期借入金	※2 300,000	※2 300,000
リース債務	5,994,960	3,960,205
繰延税金負債	—	879
未払金	5,131,497	2,614,449
未払法人税等	992,098	103,938
賞与引当金	338,135	499,503
設備関係支払手形	137,799	113,009
その他	562,181	673,995
流動負債合計	15,516,563	11,298,595
固定負債		
長期借入金	※2 300,000	—
リース債務	7,622,040	7,263,534

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
繰延税金負債	—	779,273
退職給付引当金	90,566	154,989
役員退職慰労引当金	55,552	74,259
資産除去債務	9,245	22,648
長期設備関係支払手形	138,128	36,605
その他	35,580	260,582
固定負債合計	8,251,112	8,591,893
負債合計	23,767,675	19,890,489
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,823,312	11,823,312
資本剰余金	11,380,267	11,380,267
利益剰余金	1,972,117	△3,557,859
株主資本合計	25,175,698	19,645,720
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△281,920	△298,651
その他の包括利益累計額合計	△281,920	△298,651
少数株主持分	1,663,881	1,851,236
純資産合計	26,557,660	21,198,305
負債純資産合計	50,325,335	41,088,795

(2) 連結損益及び包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
売上高	21,381,338	24,190,114
売上原価	14,532,130	19,395,219
売上総利益	6,849,207	4,794,894
販売費及び一般管理費	1,667,226	2,084,665
営業利益	5,181,981	2,710,229
営業外収益		
受取利息	3,561	4,742
設備賃貸料	44,028	32,284
受取手数料	9,114	29,150
受取補償金	—	58,036
為替差益	—	17,927
その他	11,525	25,615
営業外収益合計	68,230	167,756
営業外費用		
支払利息	234,595	252,359
貸与資産減価償却費	17,265	10,660
株式交付費	41,967	—
休止固定資産減価償却費	84,472	141,781
支払補償費	—	60,077
為替差損	13,422	—
その他	23,197	11,103
営業外費用合計	414,921	475,982
経常利益	4,835,290	2,402,003
特別利益		
固定資産売却益	120,359	247,619
負ののれん発生益	—	559,308
地方自治体助成金	126,341	262,777
特別利益合計	246,700	1,069,704
特別損失		
固定資産売却損	57,070	52,350
固定資産除却損	28,043	54,090
減損損失	※1 76,214	※1 5,388,016
貸倒引当金繰入額	—	2,701,160
ノウハウライセンス契約解約損	38,095	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,453	—
特別損失合計	201,876	8,195,618
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	4,880,113	△4,723,910
法人税、住民税及び事業税	908,473	62,208
法人税等調整額	△569,464	540,429
法人税等合計	339,009	602,637

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失 (△)	4,541,104	△5,326,547
少数株主利益	389,639	203,430
当期純利益又は当期純損失 (△)	4,151,465	△5,529,977
少数株主利益	389,639	203,430
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失 (△)	4,541,104	△5,326,547
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△91,124	△32,806
その他の包括利益合計	△91,124	△32,806
包括利益	4,449,979	△5,359,354
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	4,104,991	△5,546,709
少数株主に係る包括利益	344,988	187,354

(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	9,600,000	11,823,312
当期変動額		
新株の発行	2,223,312	—
当期変動額合計	2,223,312	—
当期末残高	11,823,312	11,823,312
資本剰余金		
当期首残高	9,156,955	11,380,267
当期変動額		
新株の発行	2,223,312	—
当期変動額合計	2,223,312	—
当期末残高	11,380,267	11,380,267
利益剰余金		
当期首残高	△2,179,347	1,972,117
当期変動額		
当期純利益又は当期純損失(△)	4,151,465	△5,529,977
当期変動額合計	4,151,465	△5,529,977
当期末残高	1,972,117	△3,557,859
株主資本合計		
当期首残高	16,577,607	25,175,698
当期変動額		
新株の発行	4,446,625	—
当期純利益又は当期純損失(△)	4,151,465	△5,529,977
当期変動額合計	8,598,090	△5,529,977
当期末残高	25,175,698	19,645,720
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定		
当期首残高	△235,446	△281,920
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△46,473	△16,731
当期変動額合計	△46,473	△16,731
当期末残高	△281,920	△298,651
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△235,446	△281,920
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△46,473	△16,731
当期変動額合計	△46,473	△16,731
当期末残高	△281,920	△298,651

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
少数株主持分		
当期首残高	1,318,893	1,663,881
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	344,988	187,354
当期変動額合計	344,988	187,354
当期末残高	1,663,881	1,851,236
純資産合計		
当期首残高	17,661,055	26,557,660
当期変動額		
新株の発行	4,446,625	—
当期純利益又は当期純損失（△）	4,151,465	△5,529,977
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	298,514	170,623
当期変動額合計	8,896,604	△5,359,354
当期末残高	26,557,660	21,198,305

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	4,880,113	△4,723,910
減価償却費	6,703,011	9,219,990
減損損失	76,214	5,388,016
負ののれん発生益	—	△559,308
貸倒引当金の増減額(△は減少)	—	2,699,019
引当金の増減額(△は減少)	138,750	29,027
受取利息	△3,561	△4,742
支払利息	234,595	252,359
設備賃貸料	△44,028	△32,284
受取補償金	—	△58,036
地方自治体助成金	△126,341	△262,777
株式交付費	41,967	—
支払補償費	—	60,077
固定資産除売却損益(△は益)	△35,245	△141,298
ノウハウライセンス契約解約損	38,095	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,453	—
売上債権の増減額(△は増加)	△994,426	1,702,013
破産更生債権等の増減額(△は増加)	—	△2,802,201
たな卸資産の増減額(△は増加)	△11,668	17,768
仕入債務の増減額(△は減少)	66,575	94,026
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△102,153	56,706
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△285,500	△71,881
その他の固定負債の増減額(△は減少)	—	226,121
その他	△4,942	△30,967
小計	10,573,908	11,057,718
利息の受取額	7,130	4,733
利息の支払額	△234,242	△252,700
補償金の受取額	—	58,036
補助金の受取額	126,341	262,777
法人税等の還付額	8,940	—
損害賠償金の支払額	—	△60,077
法人税等の支払額	△100,064	△1,256,970
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,382,013	9,813,515

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△9,127,259	△10,629,255
有形固定資産の売却による収入	564,584	457,836
無形固定資産の取得による支出	△24,721	△116,967
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	※2 △409,379
設備賃貸料の受取額	110,549	33,159
敷金及び保証金の差入による支出	△26,631	△3,250
敷金及び保証金の回収による収入	4,233	917
資産除去債務の履行による支出	△4,070	△3,800
その他	—	△1,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,503,314	△10,671,740
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	1,557,898	300,000
長期借入金の返済による支出	△300,000	△300,000
リース債務の返済による支出	△7,141,945	△6,699,426
セール・アンド・リースバック取引による収入	4,012,204	5,895,050
株式の発行による収入	4,398,032	—
ストックオプションの行使による収入	6,625	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,532,815	△804,376
現金及び現金同等物に係る換算差額	△21,015	9,074
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	4,390,498	△1,653,527
現金及び現金同等物の期首残高	2,820,690	7,211,189
現金及び現金同等物の期末残高	※1 7,211,189	※1 5,557,662

(5) 継続企業の前提に関する注記

当社の主たる株主であり、当社グループ売上高の約66%を占める主要顧客でもあるエルピーダメモリ株式会社は、平成24年2月27日に東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申し立てを行い、平成24年3月23日に同裁判所よりエルピーダメモリ株式会社に対し会社更生手続開始決定がなされました。

エルピーダメモリ株式会社は、会社更生手続開始の申し立て後もDRAM事業を継続しており、当社は引き続き申し立て以前と同レベルのウエハテスト業務を同社より受託しております。しかし、期末時点ではエルピーダメモリ株式会社の再建に向けた更生手続が開始されたものの、更生計画の認可までには至っていないという状況にあるため、エルピーダメモリ株式会社の将来に関する不確実性を当社が完全に排除することは困難であります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社では、売上高は順調に推移しており、当面の事業運営に必要な事業資金は確保しておりますが、当該状況が解消されるまで、保有設備のより一層の稼働率向上による売上収入の増加に加えて、様々な資金調達策による手元資金と設備投資用資金の更なる上積みを検討してまいります。

しかし、これらの施策に関わらず、主要な得意先であるエルピーダメモリ株式会社が更生会社となり更生計画が認可されていないため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

今後、エルピーダメモリ株式会社は、平成24年8月21日までに更生計画案を東京地方裁判所に対し提出する予定です。エルピーダメモリ株式会社のDRAM事業が継続される可能性は高いと想定しており、またエルピーダメモリ株式会社広島工場のウエハテスト工程を全量受託している当社は、更生計画認可後も引き続きウエハテスト業務を受託できる可能性は高いと考えております。エルピーダメモリ株式会社の更生計画が認可され、当社へのウエハテスト業務委託が継続される場合には、このような不確実性は解消すると考えております。

なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 2社

連結子会社の名称

TeraPower Technology Inc.

株式会社テラミクロス

上記のうち、株式会社テラミクロスについては、当連結会計年度において株式を取得したため、連結の範囲に含めております。

2. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうちTeraPower Technology Inc. の決算日は、12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

3. 会計処理基準に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

A. デリバティブ

時価法を採用しております。

B. たな卸資産

a. 製品

先入先出法又は総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

b. 仕掛品

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

c. 貯蔵品

最終仕入原価法又は総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

A. 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物	7年～50年
機械装置及び運搬具	1年～15年
その他	1年～30年

B. 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（10年以内）に基づいて償却しております。

C. 投資その他の資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、貸与資産は経済的耐用年数を40年として償却しております。

D. リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③重要な引当金の計上基準

A. 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については合理的に見積もった貸倒率により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

B. 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。

C. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（20年）により定額償却しております。

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（20年）により、発生翌連結会計年度より定額償却しております。

D. 役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく当連結会計年度末の要支給額を計上しております。

④重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均為替相場により円貨に換算し、連結子会社の換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。

⑤連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

⑥その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(7) 追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

(8) 連結財務諸表に関する注記事項
(連結貸借対照表関係)

※1.有形固定資産及び貸与資産に対する減価償却累計額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
有形固定資産の減価償却累計額	38,703,802千円	59,466,619千円
貸与資産の減価償却累計額	11,395千円	12,774千円

※2.財務制限条項は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
財務制限条項	<p>長期借入金600,000千円には、財務制限条項が付されており、以下の条項に抵触した場合には、当該借入先に対して借入金を一括返済することになっております。</p> <p>(1)純資産維持条項 貸借対照表における純資産の部の金額が7,824百万円未満となった場合</p> <p>(2)利益維持条項 損益計算書の当期純損益について、2期連続当期純損失を計上した場合</p>	<p>長期借入金300,000千円には、財務制限条項が付されており、以下の条項に抵触した場合には、当該借入先に対して借入金を一括返済することになっております。</p> <p>(1)純資産維持条項 貸借対照表における純資産の部の金額が7,824百万円未満となった場合</p> <p>(2)利益維持条項 損益計算書の当期純損益について、2期連続当期純損失を計上した場合</p>

(連結損益及び包括利益計算書関係)

※1. 減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

場所	用途	種類	金額(千円)
広島県東広島市	処分予定資産	機械装置及び運搬具、その他	76,214

当社グループは、事業用資産については事業セグメントを基本単位としてグルーピングしており、重要な貸与資産、遊休資産及び処分予定資産については、個々の資産を単位としてグルーピングしております。

広島県東広島市の処分予定資産は、当初予定していた用途での利用見込みがなくなったことに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、機械装置及び運搬具65,402千円、その他10,811千円であります。

なお、回収可能価額は、正味売却価額によって測定しており、他への転用や売却が困難であることから、備忘価額で算定しております。

当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

場所	用途	種類	金額(千円)
熊本県葦北郡	事業用資産 (半導体測定設備)	建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地、建設仮勘定等	5,282,000
熊本県葦北郡	処分予定資産	建設仮勘定	106,016

当社グループは、事業用資産については事業セグメントを基本単位としてグルーピングしており、重要な貸与資産、遊休資産及び処分予定資産については、個々の資産を単位としてグルーピングしております。

熊本県葦北郡の事業用資産は、半導体市況の悪化により収益性が悪化したことに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物1,819,673千円、機械装置及び運搬具2,993,393千円、土地171,931千円、建設仮勘定196,765千円、その他100,236千円であります。

熊本県葦北郡の処分予定資産は、当初予定していた用途での利用見込みがなくなったことに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、回収可能価額は、事業用資産については使用価値、処分予定資産については正味売却価額によって測定しております。使用価値については、将来キャッシュ・フローを8.0%で割り引いて算出しております。処分予定資産の正味売却価額については、正味売却価額によって測定しておりますが、他への転用や売却が困難である資産については、備忘価額で算定しております。

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度 期首株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式(注1)	768,000	8,514,500	—	9,282,500
合計	768,000	8,514,500	—	9,282,500

(注) 1. 普通株式の株式数の増加8,514,500株は、株式分割(1:10)による増加6,912,000株、有償一般募集による増加1,600,000株及びストック・オプションの権利行使による増加2,500株であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度 期首株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式(注1)	9,282,500	—	—	9,282,500
合計	9,282,500	—	—	9,282,500

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

該当事項はありません。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
現金及び預金勘定	7,211,189千円	5,557,662千円
現金及び現金同等物	7,211,189千円	5,557,662千円

※2. 当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに株式会社テラミクロスを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	2,273,032千円
固定資産	2,631,777千円
流動負債	△2,097,325千円
固定負債	△1,608,797千円
負ののれん	△559,308千円
取得価額	639,379千円
現金及び現金同等物	△230,000千円
差引:株式会社テラミクロス取得のための支出	409,379千円

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	69,927千円	153,347千円
貸倒引当金	-	364,313
固定資産取得価額	120,627	118,441
資本連結に伴う評価差額	-	234,337
減価償却費	285,184	311,137
減損損失	241,896	1,879,586
繰越欠損金	-	117,363
固定資産未実現利益	42,470	7,847
その他	181,485	312,621
繰延税金資産小計	941,592	3,498,996
評価性引当額	△184,486	△2,780,365
繰延税金資産合計	757,106	718,631
繰延税金負債		
特別償却準備金	△146,395	△82,971
圧縮記帳	△34,940	△75,393
固定資産取得価額	-	△169,690
資本連結に伴う評価差額	-	△80,045
差額負債調整勘定	-	△719,558
子会社の留保利益金	-	△80,095
その他	△3,154	△17,495
繰延税金負債合計	△184,490	△1,225,249
繰延税金資産との純額	572,616	△506,617

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
流動資産－繰延税金資産	184,377千円	264,977千円
固定資産－繰延税金資産	388,238	8,557
流動負債－繰延税金負債	-	△879
固定負債－繰延税金負債	-	△779,273

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
法定実効税率 (調整)	40.4%	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異については、税金等調整前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2	
評価性引当金	△29.7	
海外税率差	△4.8	
その他	0.8	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	6.9	

3. 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.44%から平成24年4月1日に開始する連結会計年度から平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.75%に、平成27年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.38%となります。

この税率変更により、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）および法人税等調整額が、それぞれ44,668千円減少しております。

(セグメント情報等)

a. セグメント情報

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品・サービスについて関係会社と連携し、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「メモリ事業」及び「システムLSI事業」の2つを報告セグメントとしております。

「メモリ事業」は、DRAM等のメモリ品のウエハテスト及び開発受託を行っております。「システムLSI事業」は、ロジック、SoC、センサ等の各種半導体のウエハテスト、ファイナルテスト、開発及びウエハレベルパッケージ受託を行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準を除き、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算については、売上高、利益又は損失、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、社内で決定した固定レートにより換算を行い、資産は、期末日の直物為替相場により換算しております。

報告されているセグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。

報告されているセグメント資産には、棚卸資産、有形固定資産及び無形固定資産を配分しております。

事業活動に直接的に関与していないセグメント資産については保有する各報告セグメントに配分しておりますが、該当する資産に関連する費用については報告セグメントに配分しておりません。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント			調整額	連結財務諸表計上額
	メモリ事業	システムL S I事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	19,618,229	1,782,690	21,400,920	△19,581	21,381,338
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	19,618,229	1,782,690	21,400,920	△19,581	21,381,338
セグメント利益又は損失（△）	7,119,686	△872,234	6,247,452	△1,065,470	5,181,981
セグメント資産	27,588,255	7,278,242	34,866,497	15,458,838	50,325,335
その他の項目					
減価償却費	5,602,797	864,561	6,467,358	56,659	6,524,018
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	13,987,951	2,147,698	16,135,650	△271,146	15,864,504

当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント			調整額	連結財務諸表計上額
	メモリ事業	システムL S I事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	19,745,878	4,529,212	24,275,090	△84,975	24,190,114
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	19,745,878	4,529,212	24,275,090	△84,975	24,190,114
セグメント利益又は損失（△）	4,970,262	△998,765	3,971,496	△1,261,267	2,710,229
セグメント資産	25,181,438	4,866,897	30,048,335	11,040,459	41,088,795
その他の項目					
減価償却費	7,819,691	1,251,250	9,070,942	△3,651	9,067,291
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	5,992,857	1,744,016	7,736,873	101,602	7,838,476

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,400,920	24,275,090
為替換算差額	△19,536	△60,996
連結消去	△44	△23,979
連結財務諸表の売上高	21,381,338	24,190,114

(単位：千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,247,452	3,971,496
為替換算差額	△6,067	△11,591
連結消去	△38,740	23,721
全社費用（注）	△1,020,663	△1,273,397
連結財務諸表の利益又は損失（△）	5,181,981	2,710,229

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに属していない一般管理費です。

(単位：千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,866,497	30,048,335
連結消去	△72,027	△2,682,495
全社資産（注）	15,530,866	13,722,954
連結財務諸表の資産	50,325,335	41,088,795

(注) 全社資産は、主に棚卸資産を除く流動資産です。

(単位：千円)

その他の項目	報告セグメント計		換算差額		連結消去		全社（注）		連結財務諸表計上額	
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	6,467,358	9,070,942	△5,733	△24,235	△13,297	△25,203	75,690	45,787	6,524,018	9,067,291
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	16,135,650	7,736,873	△24,703	△20,769	△270,005	△4,286	23,563	126,657	15,864,504	7,838,476

(注) 全社の減価償却費、全社の有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、主に一般管理費部門が使用するシステム分であります。

b. 関連情報

I 前連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1. 製品及びサービスに関する情報

(単位：千円)

	メモリ	システムL S I	合計
外部顧客への売上高	19,598,647	1,782,690	21,381,338

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	台湾	アジア	北米	合計
17,875,930	2,258,197	996,137	251,073	21,381,338

(注) 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

- (1) アジア・・・インド、中国、シンガポール、韓国、タイ
- (2) 北米・・・アメリカ

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本	台湾	合計
29,814,256	4,442,167	34,256,423

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客先	売上高	関連するセグメント名
エルピーダメモリ株式会社	15,094,109	メモリ事業

Ⅱ 当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1. 製品及びサービスに関する情報

(単位：千円)

	メモリ	システムL S I	合計
外部顧客への売上高	19,664,648	4,525,466	24,190,114

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	台湾	アジア	北米	合計
20,560,041	2,453,921	20,591	1,155,560	24,190,114

(注) 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アジア・・・インド、中国

(2) 北米・・・アメリカ

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本	台湾	合計
24,866,555	3,935,385	28,801,940

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客先	売上高	関連するセグメント名
エルピーダメモリ株式会社	16,025,269	メモリ事業

c. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

前連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

(単位：千円)

	メモリ事業	システムL S I事業	合計
減損損失	76,214	—	76,214

当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

(単位：千円)

	メモリ事業	システムL S I事業	合計
減損損失	—	5,388,016	5,388,016

d. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

前連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

e. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

前連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

負ののれんの発生益については、報告セグメントに配分しておりません。

平成23年10月1日付の株式会社テラミクロスの株式取得に伴い負ののれん発生益を特別利益に計上しております。

当該事象による負ののれん発生益の計上額は559,308千円であります。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
その他の関係会社	エルピーダメモリ㈱(注3)	東京都中央区	215,663	半導体製品の開発・設計、製造、販売	(被所有)直接39.6	ウェハテスト業務受託 役員の兼任 設備の賃借	製品の販売(注1)	14,527,459	売掛金	1,758,264
							設備賃借料、電力料 他の立替(注2)	1,911,786	未払費用	112,375

当連結会計年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
その他の関係会社	エルピーダメモリ㈱	東京都中央区	236,143	半導体製品の開発・設計、製造、販売	(被所有)直接39.6	ウェハテスト業務受託 設備の賃借	製品の販売(注1)	15,615,319	売掛金	618,829
									破産更生債権等(注4)	2,732,746
							設備賃借料、電力料 他の立替(注2)	2,132,687	買掛金	1,003
									未払金	284,416
未払費用	124,339									

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 製品の販売価格は、総コストを勘案して交渉により決定しております。

2. 設備賃借料については、対象資産の償却費に固定資産税、保険料、金利相当額を加えた価格で取引を行っております。電力料については、当社の電力使用量に応じた電気料金相当額の請求となっております。他の立替の主な要素である業務委託料については、当社に対する用役提供の割合に応じた人件費相当額の請求となっております。

3. エルピーダメモリ株式会社は、平成22年12月に当社に対する議決権所有割合が減少したことにより、親会社からその他の関係会社に属性を変更しております。ただし、取引金額は通年のものを記載しております。

4. エルピーダメモリ株式会社への破産更生債権等に対し、2,331,548千円の貸倒引当金を計上しております。また当連結会計年度において2,331,548千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

(企業結合等)

取得による企業結合

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社テラミクロス

事業の内容 WLP等の研究、開発、設計、製造及びその販売

(2) 企業結合を行った主な理由

当社は、ウエハレベルパッケージ関連事業を取得することで、新たな成長戦略ドメインのひとつとしてウエハテスト受託事業とのシナジー効果が期待される、ターンキービジネス領域の強化・拡大を図ることを目的としております。

(3) 企業結合日

平成23年10月1日

(4) 企業結合の法的形式

株式の取得

(5) 結合後企業の名称

株式会社テラミクロス

(6) 取得した議決権比率

100%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社による、現金を対価とする株式取得であるため。

2. 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成23年10月1日から平成24年3月31日まで

3. 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 現金 600,000千円

取得に直接要した費用 デューデリジェンス費用等 39,379千円

取得原価 639,379千円

4. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	2,273,032千円	流動負債	2,097,325千円
固定資産	2,631,777千円	固定負債	1,608,797千円
		純資産	1,198,687千円
総資産	4,904,810千円	負債及び純資産合計	4,904,810千円

5. 企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損計算書に及ぼす影響の概算額

売上高 2,775,023千円

経常利益 △272,382千円

当期純利益 △188,021千円

(概算額の算定方法)

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と当社の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額としております。

なお、当該概算額は、監査証明を受けておりません。

6. 発生した負ののれんの金額、発生原因

①発生したのれんの金額

559,308千円

②発生原因

企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ったことによるものであります。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	2,681.80円	2,084.25円
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)	509.44円	△595.74円

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失金額であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前年連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
当期純利益金額又は当期純損失金額(△) (千円)	4,151,465	△5,529,977
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失金額 (△)(千円)	4,151,465	△5,529,977
期中平均株式数(株)	8,149,056	9,282,500
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成20年2月15日臨時株主総会 決議ストック・オプション 453,700株 平成22年3月19日臨時株主総会 決議ストック・オプション 54,500株	平成20年2月15日臨時株主総会 決議ストック・オプション 438,200株 平成22年3月19日臨時株主総会 決議ストック・オプション 47,900株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。